

H150

常规系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30℃

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2 年

不符合储存条件下：6 个月

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	粉红色	---	目视
厚 度	0.3~18	mm	ASTM D 374
硬 度	10~55(±5)	Shore C	ASTM D 2240
密 度	2.0(±0.5)	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.25	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥80	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥25 (@50psi)	%	ASTM D 575
阻燃等级	V-0,5V	---	UL-94
使用温度	-50~180	℃	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	1.5(±0.2)	W/m • K	ASTM D 5470
热 阻	≤1.5 (@20Psi/1mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ¹⁰	Ω • cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权